

Title (en)

Method of manufacturing a contact for a vacuum switch

Title (de)

Verfahren zum Herstellen einer Kontaktanordnung für eine Vakuumschaltröhre

Title (fr)

Procédé de fabrication d'un contact pour interrupteur à vide

Publication

EP 1022760 A2 20000726 (DE)

Application

EP 00100967 A 20000119

Priority

DE 19902500 A 19990122

Abstract (en)

A contact piece (10,20) is pressed directly onto the surface of a contact carrier (1,2), leaving a gap along the contact surface. A solder material is arranged in regions directly adjoining the gap, between the contact piece and contact carrier. Under vacuum, the solder material is melted by heating and the molten material penetrates the gap between the contact carrier and the contact piece.

Abstract (de)

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen einer Kontaktanordnung für eine Vakuumschaltröhre mit einem Kontaktträger und mit einem damit mittels eines Lotmaterials unter Vakuum verbundenen Kontaktstücks, wobei der Kontaktträger aus elektrisch gut leitendem Material, zum Beispiel aus Kupfer, und das Kontaktstück aus einem abbrandfesten und Kupfer enthaltenden Sintermaterial besteht, wobei das Kontaktstück unmittelbar flächig auf den Kontaktträger unter Ausbildung eines Spaltes entlang der Berührungsfläche angedrückt wird und das Lotmaterial an an den Spalt der Berührungsfläche zwischen Kontaktstück und Kontaktträger unmittelbar angrenzenden Bereichen angeordnet wird und danach unter Vakuum durch Zufuhr von Wärme das Lotmaterial zum Aufschmelzen gebracht wird und das aufgeschmolzene Lotmaterial in den Spalt der Berührungsflächen zwischen Kontaktträger und Kontaktstück eindringt. <IMAGE>

IPC 1-7

H01H 33/66

IPC 8 full level

H01H 33/664 (2006.01); **H01H 1/02** (2006.01); **H01H 11/04** (2006.01)

CPC (source: EP US)

H01H 33/664 (2013.01 - EP US); **H01H 1/0206** (2013.01 - EP US); **H01H 11/045** (2013.01 - EP US); **Y10T 29/49208** (2015.01 - EP US); **Y10T 29/4921** (2015.01 - EP US); **Y10T 29/49211** (2015.01 - EP US); **Y10T 29/49213** (2015.01 - EP US)

Cited by

CN117548886A; WO2012098003A1; WO2022069263A1

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE

DOCDB simple family (publication)

EP 1022760 A2 20000726; **EP 1022760 A3 20010502**; **EP 1022760 B1 20051221**; AT E313852 T1 20060115; DE 19902500 A1 20000817; DE 19902500 B4 20040722; DE 50011875 D1 20060126; ES 2255470 T3 20060701; US 6574864 B1 20030610

DOCDB simple family (application)

EP 00100967 A 20000119; AT 00100967 T 20000119; DE 19902500 A 19990122; DE 50011875 T 20000119; ES 00100967 T 20000119; US 48875500 A 20000121